

## 【閎康產學合作計畫】

### 閎康提供高階分析儀器服務，推動基礎及應用研究

為提升新元件與新材料在研發過程中的分析檢測品質，促進產業升級，閎康科技擬每年投入新台幣 2000 萬元整，補助以開發高科技產品和製造、封裝、測試與系統等主題，運用先進分析檢測為手段之研究計畫。

閎康科技邀請參與相關領域研究的優秀學者，由我們提供高階分析儀器服務，結合學界的研究資源，合作推動基礎及應用研究，一起共創產學雙贏。

#### 110 年度計畫時程

- 徵件時間：自 110 年 5 月 1 日 起開始收件，至 110 年 6 月 15 日 截止受理。
- 結果公告：最晚於 110 年 6 月 30 日 前將遴選結果通知各服務中心與申請人。
- 計畫執行時間：補助自 110 年 8 月 1 日起 至 111 年 7 月 31 日止。

#### 徵件對象

以科技部「基礎研究核心設施服務中心」為合作平台，其包含 臺灣大學、臺灣師範大學、清華大學、陽明交通大學、中央大學、中興大學、成功大學、中山大學 等八校。

計畫主持人需具備科技部專題研究計畫主持人資格，並任職於受理服務中心所在機構，每人每年以申請一件為限。

#### 遴選重點

- 研究主題以**半導體、光電材料、製造封裝**等相關領域優先。
- 具創新或未來應用發展潛力。
- 計畫之執行需使用閎康科技所提供之分析儀器。

補助項目由閎康科技提供下列尖端分析測試服務。依儀器設備分為 9 大領域：

1. 非破壞性結構觀察 (3D x-ray, SAT, Thermal EMMI)
2. 微結構與成份分析 (樣品製備, 高解析 TEM, SEM, FIB, EDS, EBSD, EELS, NBD, SAD)
3. 雜質濃度檢測 (SIMS, SRP, SCM, XPS, Auger)
4. 污染與微量檢測 (TOF-SIMS, XPS, FTIR, XRF)
5. 液態 TEM 分析 (K-kit)
6. 元件級電性量測與缺陷定位 (C-AFM, Nano-probing, EBIC/EBAC, PEM, OBIRCH, Thermal EMMI)
7. ESD (HBM, MM, CDM, Latch-up, TLP, EOS)
8. 可靠度測試 (HTOL, HAST, TCT, BLT, TS, Vibration, Shock, H2S corrosion, AMR/AMI, HRTB, ...etc.)
9. 物理化學分析 (ICP-MS, TGA, LC-MS, ...etc.)

## 經費補助

審查通過之計畫，閎康科技得要求計畫主持人提供詳細之實驗內容與步驟，商訂補助之經費。閎康暫規劃，總補助經費約 70%需屬閎康檢測費 (需逐次繳回)、20%校管理費、10%耗材雜支等業務費。

## 簽約

依各校產學計畫相關規定辦理。

## 執行

- (一) 計畫主持人需提供至少期初計畫、期中進度報告與期末進度報告，計畫執行期間可隨時與閎康科技討論研究方法與進度。
- (二) 閎康科技得就每個計畫安排一位專案聯絡人(PM)接洽收送件與技術討論事宜。

## 聯絡方式

計畫主持人須具備科技部專題研究計畫主持人資格，並任職於八校服務中心所在機構，每人以申請一件為限。請依附件產學計畫書格式製作文件，並依公告截止期限內將電子檔郵寄閎康科技行政窗口，計畫內容相關疑問請洽技術窗口。逾期、文件不全或不符合規定者，不予受理。

閎康行政窗口 吳方琪小姐, (03)611-6678 ext: 4310, pm\_cs@ma-tek.com

技術聯絡窗口 陳弘仁先生, (03)611-6678 ext: 3250, JDP@ma-tek.com

## 閎康科技股份有限公司本計畫網頁公告

[https://www.ma-tek.com/zh-TW/News\\_Release/detail/all/all/20210501](https://www.ma-tek.com/zh-TW/News_Release/detail/all/all/20210501)

## 申請書等相關檔案下載

[https://www.ma-tek.com/zh-TW/Download/index/Application\\_Forms/Form](https://www.ma-tek.com/zh-TW/Download/index/Application_Forms/Form)